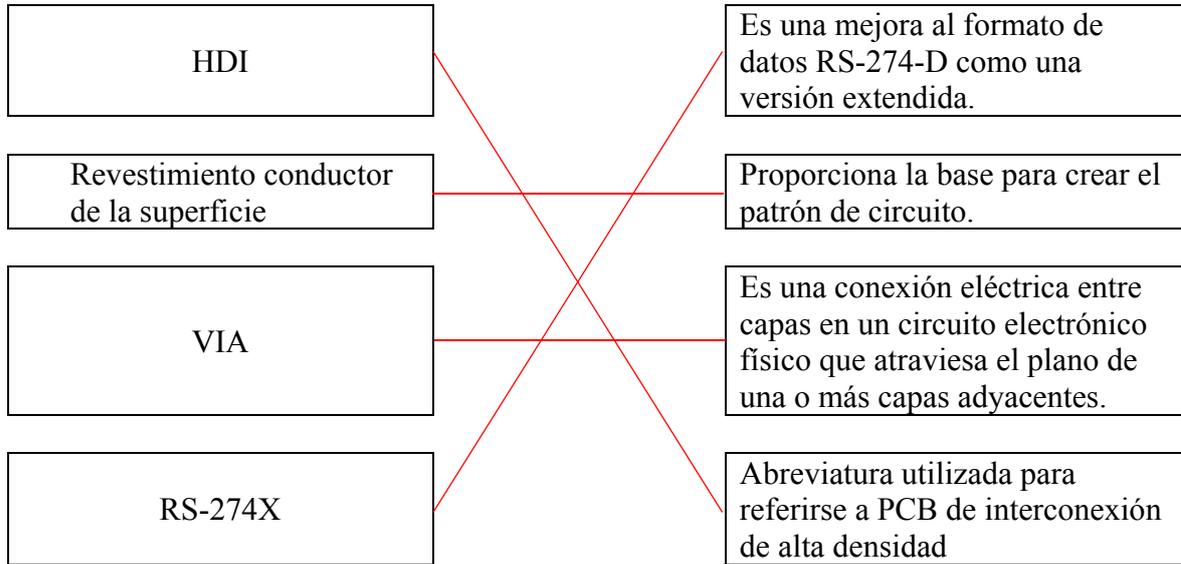


**1. Asigne los términos de la columna izquierda a las definiciones correspondientes a la derecha.**



**2. Enumere tres características básicas de las placas de circuito impreso de interconexión de alta densidad.**

1. Mayor densidad de cableado por unidad de área que las PCB convencionales.
2. Tienen líneas y espacios más finos.
3. Tienen vías más pequeñas, pads de captura y una densidad de pads de conexión muy alta.

**3. Corrija el texto para que las siguientes afirmaciones sean ciertas.**

Los pines de la fuente de alimentación se deben desacoplar directamente del plano de tierra mediante el uso de ( ~~inductancias~~ **condensadores cerámicos** ) lo más cerca posible de los pines de alimentación del circuito integrado.

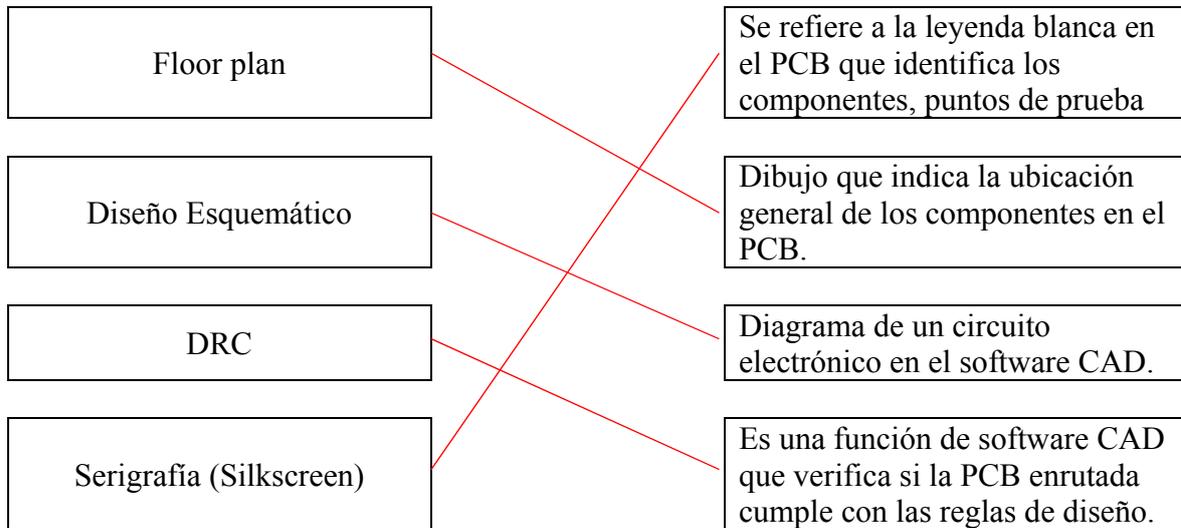
En general, frecuencias superiores a 1GHz ( ~~1 MHz~~ **1 GHz** ) son consideradas altas frecuencias.

Los PCBs de una capa son fabricados de un sola capa de ( ~~material base o substrato~~ **resina** ).

Las PCB con respaldo de aluminio : Aluminum backed PCBs, se componen de un refuerzo de ( ~~Al~~ **Al** ) una capa dieléctrica altamente conductora térmicamente y una capa de circuito estándar.

Las PCB rigid-flex, combinan lo ( ~~peor~~ **mejor** ) de las placas rígidas y flexibles integradas juntas.

**4. Asigne los términos de la columna izquierda a las definiciones correspondientes a la derecha.**



**5. Enumere un mínimo de 5 pasos básicos del proceso de fabricación de PCB.**

1. **Film generation**
2. **Perforación**
3. **Proceso de grabado (Etching)**
4. **Máscara de soldadura**
5. **Serigrafía**

## 6. Corrija el texto para que las siguientes afirmaciones sean ciertas.

Mantener las masas digitales y analógicas (~~digital~~ <sup>juntas</sup> ~~separadas~~) porque los picos de tensión y los de corriente desde circuitos (~~digital~~ <sup>analóg</sup>) pueden generar ruido de interferencia en los circuitos (~~analógicos~~ <sup>digitales</sup>).

Al ubicar los componentes, (~~maximizar~~ <sup>minimizar</sup>) las distancias y evitar ángulos de (~~45~~ <sup>90</sup>) grados.

Los fabricantes utilizan un (~~impresora~~ <sup>plotter óptico</sup>) para obtener una imagen (~~negative~~ <sup>digital</sup>) del PCB.

Las señales sensibles deben ser (~~mantenidas aparte~~ <sup>blindadas</sup>) de las fuentes de ruido con planos y debe realizarse un control de impedancia.

